

プレスリリース

X-FAB が専門ファウンダリーとして初めて 直ちに利用可能なホールセンサーの供給を開始

***XH018 高耐圧プロセスに新デバイスとデザインキットを追加し、
System-on-Chip (SoC)の設計時間とコストを削減***

2010年11月30日(ドイツ、エルフルト) - アナログ/ミックスドシグナル ファウンダリーのトップ企業であり、卓越した「More than Moore」の技術を誇る [X-FAB シリコンファウンダリー社](#)は本日、ホール効果の機能を集積化し、十分な特性評価とドキュメント化がされ、直ちに利用可能なホールセンサー素子として供給する初めての専門ファウンダリーとなりました。X-FAB の 0.18 ミクロン高耐圧プロセス(XH018) に組み込まれたローパワーで高感度のこの磁気センサー素子は、バッテリーで駆動されるアプリケーションに最適です。センサーアプリケーション全体にわたるシステム構成を、さらに費用効果の高いシングルチップへと変更でき、追加のレイアウト作業・チップテスト・測定・最適化などが不要となります。X-FAB はさらに、このデバイスをチップの残りの回路と上手く集積化するために必要な全てのものを含む追加デザインキットを供給します。12月8日・9日に、世界に向けて無料で開催されるウェビナー「Foundry Solution for Hall Sensor Applications – Integrated Magnetic Field Sensing Made Easy with Ready-to-Use Hall Device」で、このホールセンサーに関して詳しく紹介する予定です。

この新しいホールセンサーは、磁気的非接触検出・測定や、距離・場所・回転角・速度・電流などを間接的に測定するために磁気が使われるアプリケーションに適しています。例えば、携帯端末の近接センサー、自動車の速度センサー、機械的なスイッチの置き換え、DC モーターのブラシレスコントロール、スマートグリッドの液面検出・メーターなどに利用できます。この新しいセンサーは、非常に小さい電流で動作します。さらに、オフセット・感度・温度特性などに関して十分な特性評価がされており、IP ブロックとして提供され、直ちに利用可能な基本素子としてお使いいただけます。

追加デザインキットには VerilogA モデルが含まれ、X-FAB のモジュール化された XH018 プロセスでシミュレーションが可能です。このプロセスは厳しい自動車の認定基準を満たしており、SoC デザイナーはホール効果の機能を、オフセットキャンセル・精密な信号処理・高密度ロジック・マイクロプロセッサ・不揮発性メモリー・高耐圧アナログ素子・パワードライバーなどと集積化することができるようになります。直ちに利用できるこのホールセンサー素子を使うことにより、デザイン過程での時間と費用を大幅に削減できます。

X-FAB の新しいホールセンサーはすでに利用可能です。評価用のシリコンサンプルも提供可能です。デザインキットは、X-FAB のオンラインテクニカルインフォメーションセンター (X-TIC) からダウンロードできます。

X-FAB について

X-FAB は、アナログ/ミックスドシグナル集積回路 (ミックスドシグナル IC) 向けのシリコンウエハを製造し、アナログ/ミックスドシグナルの分野で世界をリードするファウンダリーです。製造拠点はドイツのエルフルトおよびドレスデン、米テキサス州のラボック、マレーシアのサラワク州クチンにあり、約 2400 名の従業員が世界中で勤務しています。ウエハは 1.0um から 0.18um にわたる技術を備えた、モジュール化 CMOS 及び BiCMOS 先端プロセスで製造されており、そのアプリケーションは主に自動車、通信、民生、産業の各分野に広がっています。詳しい情報は www.xfab.com をご覧ください。

X-FAB 広報お問い合わせ

Thomas Hartung
VP Marketing
+49-361-427-6160
Thomas.Hartung@xfab.com

ThinkBold Corporate Communications
Dagmar Berendes
+1-408-379-2344
dagmar@thinkbold.com

Sarah Miller
+1-231-264-8636
sarah@thinkbold.com